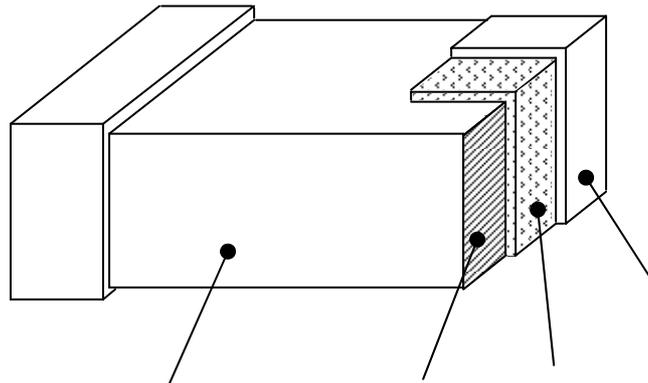


チップポジスタ 構造材質図  
Chip POSISTOR Construction

( PRF15\*\*\*\*\*B6RC )



No.	材料 Material
	BaTiO3 系セラミック半導体 BaTiO3 Semiconductive Ceramics
	下地電極 (スパッタ電極) Under Electrode (Sputtering)
	Ag 厚膜外部電極 Ag Thick Film Outer Electrode
	Ni めっき, Sn めっき Ni Plating + Sn Plating

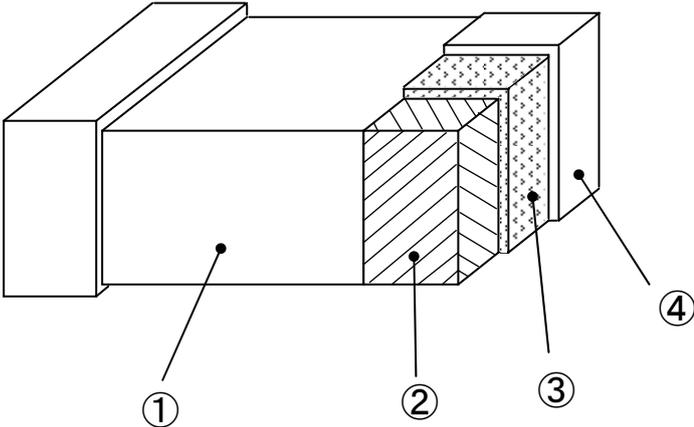
\* 内部電極はありません。

\* Non Inner-electrode



チップポジスタ® 構造材質図  
Chip POSISTOR® Construction

(PR\*\*\*\*\*5R\*Series)



No.	材料 Material
①	BaTiO <sub>3</sub> 系セラミック半導体 BaTiO <sub>3</sub> Semiconductive Ceramics
②	下地電極 (Ni合金層) Electrode (Ni Alloy)
③	Niめっき Ni plating
④	Snめっき Sn Plating

\*内部電極はありません。  
\* Non Inner-electrode